

Supplier Search Program RFI Form

<日本語/Japanese>

<English>

参加目的	Purpose
・弊社のニーズにマッチした製品を効率よく探索する。 ・Face to Faceで弊社の要望を確実に伝えて、要求する製品を的確に紹介して頂く。	・Efficiently search for products that match our company's needs. ・By clearly conveying our requests in face-to-face meetings, exhibitors at SEMICON Japan can accurately introduce the products we request.
提案希望 その1	#1 Subscription Requirements
タイトル： 低応力モールド (Low Stress Mold Compound)	Title : Low Stress Mold Compound
内容： QFNの薄型化、チップ占有率大、Cu Clipなどへの対応により、機械的ストレスを低減させたいNPI機会が増える為、低応力モールドを探している。	Detail : With the trend of making QFNs thinner, higher chip occupancy, and support for things like Cu Clips, there are more NPI opportunities where we want to reduce mechanical stress. So we are looking for a low-stress mold compound.
提案希望 その2	#2 Subscription Requirements
タイトル： Warpage計測の最新動向	Title : Latest Trends in Warpage Measurement
内容： リフロー中やTC中などの動的なWarpage計測。インラインでの反り測定はできないか？	Detail : Measuring dynamic warpage during reflow or TC and. Is it possible to measure warpage inline?
提案希望 その3	#3 Subscription Requirements
タイトル： 低コスト化	Title : Cost reduction
内容： 100mmを超えるLF、基板作製の実現	Detail : The feasibility of making LF or substrates over 100mm
提案希望 その4	#4 Subscription Requirements
タイトル： AI模倣学習 (Imitation Learning)	Title : AI Imitation Learning
内容： ・ティーチングレス化や作業自動化を実現する技術 ・ロボットへの技能伝承、Physical AI関連ソリューション	Detail : ・Teaching-less robot programming ・Skill transfer and Physical AI-related solutions
提案希望 その5	#5 Subscription Requirements
タイトル： 3D補正・3Dビジョン技術	Title : 3D Vision and Calibration Technologies
内容： ・3Dカメラ、ビジョンガイダンス ・キャリブレーション、位置補正、バラ積みピッキング技術	Detail : ・3D cameras and vision guidance systems ・Calibration, position correction, and bin-picking applications
提案希望 その6	#6 Subscription Requirements
タイトル： 裏面露光時のアライメントずれ測定装置	Title : Backside exposure alignment shift measuring device
内容： 裏面露光を表面に合わせて行った場合の表面と裏面のアライメントずれの測定装置。特に、全面にメタルが成膜されて、光を通さない場合の測定。	Detail : A measurement device for checking alignment shift between the front and back sides when the back-side exposure is aligned with the front. Especially used when metal is deposited over the entire surface and light cannot pass through.
提案希望 その7	#7 Subscription Requirements
タイトル： Φ300mm 一括露光装置	Title : Φ300mm all at once exposure machine
内容： Φ300mm基板上にラフパターンを一括露光で作成する。	Detail : Create a rough pattern all at once on a Φ300mm substrate using exposure.(not stepper)
提案希望 その8	#8 Subscription Requirements
タイトル： Φ300mm Siの裏面プロセスの受託	Title : Outsourcing the back-side process of Φ300mm Si
内容： Φ300mm Siを30um程度に薄膜化後、裏面メタルを成膜し、その膜をパターンニングする工程の受託	Detail : Outsourcing back-side process. For example of thinning a Φ300mm Si wafer to about 30um and depositing metal on the back, and patterning that film.
提案希望 その9	#9 Subscription Requirements
タイトル： 裏面用Cu電解めっき液	Title : Cu electroplating solution for the back side
内容： 裏面全体にCuめっきを行うような大パターン用の、高速で安価なCu電解めっき液	Detail : A fast and cheap Cu electroplating solution for large patterns, meant to coat the entire back side with Cu plating. metal on the back, and patterning that film.
提案希望 その10	#10 Subscription Requirements
タイトル： 高放熱TIM1材料	Title : High Thermal Conductivity TIM1 material
内容： FCBGAの消費電力増に伴い、チップ表面と放熱板(Lid)を接続するTIM1材料に更なる高熱伝導率が求められている。TIM1に適用できる高放熱TIM1材料をご紹介下さい。	Detail : Because the increasing power consumption of FCBGA packages, there is a growing demand for TIM1 materials with even higher thermal conductivity to connect the backside of the chip to the heat spreader (lid). We would like to introduce high thermal conductivity TIM1 materials suitable for this application.
提案希望 その11	#11 Subscription Requirements
タイトル： MIS(Molded Interconnect Substrate)材料	Title : MIS(Molded Interconnect Substrate) material
内容： MISの製造を担うサプライヤー又は、MISを用いた半導体パッケージの組立(少量、開発向け)実績ある企業をご紹介下さい。	Detail : Could you please provide information on suppliers that manufacture MIS, as well as companies with experience in assembling semiconductor packages using MIS for prototype builds, engineering samples, or low-volume production?
提案希望 その12	#12 Subscription Requirements
タイトル： 低コスト 高熱伝導 低電気抵抗 高信頼性ダイボンダ材	Title : Next-Gen Die Attach Material: Low Cost, High Thermal Conductivity, Low Electrical Resistance, and High Reliability
内容： ・プレッシャーレスAg or Cu sintering材で従来の銀ベストと同等レベルのコスト ・温度サイクル2000cycleレベルでも剥離やクラックが発生しない高信頼性を実現できるダイボンダ材	Detail : - Die Attach Material Enabling Low-Cost Pressureless Ag/Cu Sintering with Outstanding Reliability (No Delamination or Cracking up to 2,000 Temperature Cycles)
提案希望 その13	#13 Subscription Requirements
タイトル： 車載向け2.5Dパッケージ用アンダーフィル材	Title : Underfil materia for Automotive 2.5D package
内容： 自動車向け信頼性試験(-55℃～125℃の温度サイクル1000回)でもクラックが発生せず、かつマイクロバンプを保護できるアンダーフィル材	Detail : - An underfill material that protects micro-bumps without cracking during automotive reliability testing (1,000 temperature cycles from -55°C to 125°C).